

488696-2026 - Gara

Irlanda – Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Descrizione: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificativo della procedura: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): South-East (IE052)

Paese: Irlanda

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 4

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Descrizione: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificativo interno: 1

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): South-East (IE052)

Paese: Irlanda

5.1.3. Durata stimata

Durata: 48 Mesi

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: inglese

Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: inglese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese

Catalogo elettronico: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Luogo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non ancora noto

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: The High Court of Ireland

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: The High Court of Ireland

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione che tratta le offerte: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Descrizione: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificativo interno: 2

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): South-East (IE052)

Paese: Irlanda

5.1.3. Durata stimata

Durata: 48 Mesi

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: inglese

Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: inglese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese

Catalogo elettronico: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Luogo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non ancora noto

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: The High Court of Ireland

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: The High Court of Ireland

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione che tratta le offerte: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lotto: LOT-0003

Titolo: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Descrizione: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificativo interno: 3

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): South-East (IE052)

Paese: Irlanda

5.1.3. Durata stimata

Durata: 48 Mesi

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: inglese

Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: inglese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese

Catalogo elettronico: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Luogo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non ancora noto

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: The High Court of Ireland

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: The High Court of Ireland

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione che tratta le offerte: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lotto: LOT-0004

Titolo: Plasma Deposition ,PECVD

Descrizione: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificativo interno: 4

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): South-East (IE052)

Paese: Irlanda

5.1.3. Durata stimata

Durata: 48 Mesi

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: inglese

Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: inglese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese

Catalogo elettronico: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Luogo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non ancora noto

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: The High Court of Ireland

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: The High Court of Ireland

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Education Procurement Service (EPS)

Organizzazione che tratta le offerte: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Education Procurement Service (EPS)

Numero di registrazione: IE 6609370 G

Indirizzo postale: Castletroy Limerick

Località: Limerick

Codice postale: V94 DK53

Suddivisione del paese (NUTS): Mid-West (IE051)

Paese: Irlanda

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Telefono: 000

Indirizzo internet: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profilo del committente: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

Organizzazione che tratta le offerte

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: The High Court of Ireland

Numero di registrazione: The High Court of Ireland

Servizio: The High Court of Ireland

Indirizzo postale: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Località: Dublin

Codice postale: D07 WDX8

Suddivisione del paese (NUTS): Dublin (IE061)

Paese: Irlanda

E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefono: +353 1 8886000

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: European Dynamics S.A.

Numero di registrazione: 002024901000

Servizio: European Dynamics S.A.

Località: Athens

Codice postale: 15125

Suddivisione del paese (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Paese: Grecia

E-mail: eproc-esender@eurodyn.com

Telefono: +30 2108094500

Ruoli di questa organizzazione:

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Motivo principale della modifica

:

Aggiornamento informazioni

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale,
ora legale dell'Europa occidentale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: inglese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 488696-2026

Numero dell'edizione della GU S: 134/2026

Data di pubblicazione: 15/07/2026